

JP2000351947/PN

L4 ANSWER 1 OF 1 CA COPYRIGHT 2001 ACS

ACCESSION NUMBER: ***134:30268*** CA

TITLE: Heat-releasable multilayer adhesive sheets having expandable layers for electronic device fabrication
INVENTOR(S): Murata, Akihisa; Ohshima, Toshiyuki; Arimitsu, Yukio; Kiuchi, Kazuyuki

PATENT ASSIGNEE(S): Nitto Denko Corp., Japan

SOURCE: Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 7 pp.

CODEN: JKXXAF

DOCUMENT TYPE: Patent

LANGUAGE: Japanese

INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: C09J007-02

SECONDARY: B32B005-20; B32B007-10; B32B025-08; B32B027-00;

B32B027-18; C09J121-00

CLASSIFICATION: 38-3 (Plastics Fabrication and Uses)

Section cross-reference(s): 76

FAMILY ACC. NUM. COUNT: 1

PATENT INFORMATION:

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
JP 2000351947	A2	20001219	JP 1999-166723	19990614

ABSTRACT:

The sheets comprise substrates and .gtoreq.2 layers contg. thermally expandable microparticles, where the microparticles in outermost layers have the highest expansion initiation temp. (T). Thus, a polyester film was coated with a 100:15:15 mixt. of an acrylic adhesive (contg. 100 parts Et acrylate-2-ethylhexyl acrylate-Me methacrylate copolymer and 1.5 polyurethane crosslinking agent), Microsphere F 301D (T 100.degree.), and Microsphere F 80SD (T 150.degree.) and a 100:30 mixt. of the adhesive and Microsphere F 80SD and applied to a ceramic sheet to give a test piece showing good peelability after heating at 100-150.degree. for 120 s.

=> logoff y

COST IN U.S. DOLLARS

SINCE FILE
ENTRY

TOTAL
SESSION
\$9.33

FULL ESTIMATED COST

DISCOUNT AMOUNTS (FOR QUALIFYING ACCOUNTS)

SINCE FILE
ENTRY
-0.56

TOTAL
SESSION
-0.56

CA SUBSCRIBER PRICE

STN INTERNATIONAL LOGOFF AT 10:22:16 ON 28 MAR 2001

@+
?

@+
?

@+
?

@
OK
ATHZ
OK

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-351947

(P 2000-351947 A)

(43) 公開日 平成12年12月19日(2000.12.19)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ド (参考)
C 0 9 J	7/02	C 0 9 J	7/02 Z 4F100
B 3 2 B	5/20	B 3 2 B	5/20 4J004
	7/10		7/10 4J040
	25/08		25/08
	27/00		27/00 M
審査請求 未請求 請求項の数 4		OL	(全 7 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-166723

(22) 出願日 平成11年6月14日(1999. 6. 14)

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72) 発明者 村田 秋桐

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電工
株式会社内

(72) 発明者 大島 俊幸

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電工
株式会社内

(74) 代理人 100088007

弁理士 藤本 勉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 加熱剥離型粘着シート

(57) 【要約】

【課題】 電子部品の小型化等に伴う多数のカット溝が形成された場合にも良好に接着力を低減できる加熱剥離型粘着シートの開発。

【解決手段】 基材(1)の少なくとも片側に、熱膨張性微小球を含有する熱膨張性層の2層以上の重畳層を有し、その基材より最遠方の熱膨張性層(4)が最高の熱膨張開始温度を示す熱膨張性微小球を含有して粘着性を示すと共に、その最遠方の熱膨張性層と基材との間に熱膨張開始温度が前記最高温度よりも低温の熱膨張性微小球を含有する熱膨張性層(3)を有する加熱剥離型粘着シート。

【効果】 電子部品等を接着保持する熱膨張性層が膨張する前に、より低温で膨張する内側の熱膨張性層が膨張して接着用の熱膨張性層に形成されたカット溝が埋められ、その後に接着用の熱膨張性層が膨張してその膨張変形を接着力の低減に効率よく利用でき、接着力を安定して低減させうる。

